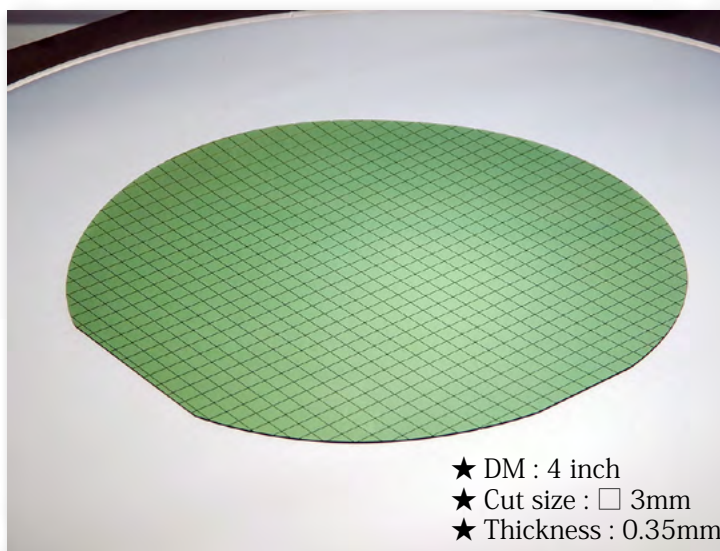




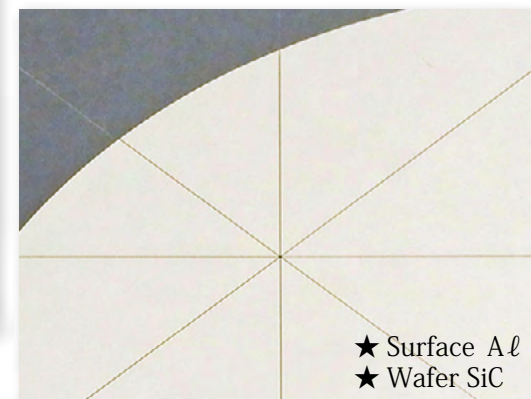
SoundCutting application

〈半導体ウェハー・SiC(炭化ケイ素)の音波フルカット〉



★ DM : 4 inch
★ Cut size : □ 3mm
★ Thickness : 0.35mm

半導体ウェハー・SiC(炭化ケイ素)のフルカット



★ Surface Al
★ Wafer SiC

アルミ蒸着 SiC の放射状のフルカット

- ブレードの耐摩耗性のアップ
- 大きなチッピングの防止
- 難切材の高速カット
- ダメージが発生しない
- 歩留まり 100%

